

# WSK900B数控金刚线切片机



## 设备用途与性能特征

- 本设备为金刚线切割机床，主要用于新能源行业，单晶硅棒、多晶硅棒的切片、石英材料等行业脆性材料切割，是新能源的主要配套设备；
- 本设备可以切割158×158到230×230范围内所有晶片。当晶片规格在158×158到188×188之内时，采用双导轮切割模式，其布线简单。当晶片规格在188×188到230×230时采用三导轮切割模式，其避免了由中心距过大引起的“线弓”和张力波动。
- 设备布局合理，机械强度高而起热稳定性好；
- 采用西门子Simotion运动控制技术的一体化PC机，15"触控屏，配有原创的双层布线专用线匝管理系统；
- 配有收放线室、切割室安全门锁，保障人员安全，同时配有左右检修门，方便维护保养

## Application and features

- The equipment is diamond wire saw slicing machine,applier in new energy industry,processing monocrystalline silicon and polysilicon round bar,quartz material and hard brittle material,which is the main equipment for new energy industry.
- The equipment cuts all wafer in the extent of 158×158 to 230×230. when wafer specification between 158×158 and 188×188, double guide wheel cutting mode will be used, which easy to wiring. when wafer specification between 188×188 and 230×230,triple guide wheel cutting mode will be used, which can avoid arcus linearis and tension fluctuation caused by over big center distance.
- Reasonable layout,high mechanical strength and perfect thermal stability.
- Apply integrated PC of SIEMENS Simotion controlling system,15"touch screen.
- With security lockfor winding room,cutting room to protect the safety of personnel ,and equippeed accessdoor,easy to maintenance.

# WSK900B数控金刚线切片机

## WSK900B数控金刚线切片机规格参数

Specification of WSK900B CNC Diamond Wire Saw Slicing Machine

### 加工工件参数 work piece parameter

横截面 Cross section	180mm×180mm/230mm×230mm
最大长度 Max Length	900mm
最小厚度 Min thickness of water	>0.1mm(须调整工艺)

### 能源供给 power supply

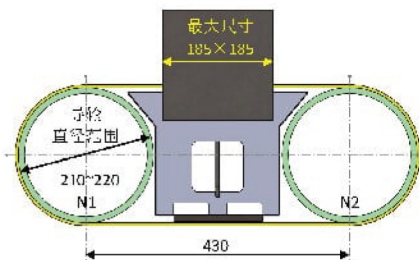
电源要求 Power connection	电压380V 频率50Hz
冷却水温 Cooling water	8-17℃
环境温度 Environmental temperature	15℃-25℃

### 主要参数 main parameter

导轮直径 Diameter of guide wheel	Φ194mm/Φ220mm
导轮轴距 Wheel base of guide wheel	430mm
导轮长度 Length of guide wheel	920mm
进给速率 Speed rate of work piece	0.01mm-10mm/min
工作行程 Operating stroke	385mm
线速度 Line speed	40m/s
切割方向 Slicing orientaion	前进或后退切割/双向切割(Forward or backward slice/two-Way exchange of cutting)
切削液箱容量 Capacity of cutting fluid	>500L
机床外形尺寸(长×宽×高) Equipment size (L*W*H)	4470×2100×3370mm

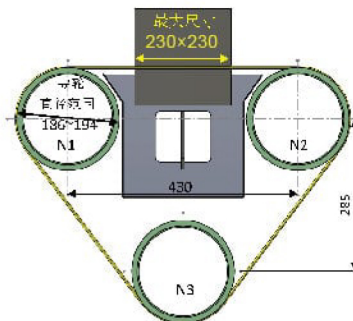
### 设备示意图 sketch

#### 双导轮模式



晶片规格在158×158到188×188之内时,采用双导轮切割模式,其布线简单,结构设计成熟,可靠性、稳定性高,维护成本低,适用于目前主流产品的切割。

#### 三导轮模式



晶片规格在188×188到230×230时,采用三导轮切割模式,与两导轮模式切换方便,无需担心同轴度的高精度要求。避免了由于中心距过大引起的“线弓”和张力波动。